



C.C.P.



**CCP Contact Probes**

股票代號: 6217

**2024年中國探針(股)公司法人說明會**

**2024.11.13**



本簡報係建立於本公司從目前各項來源所取得之資訊，部分資訊可能受未來不確定性因素影響，造成預期狀況與實際狀況有所差異，若實際狀況與本公司對於未來前景說明有差異，或有變更或調整時，請以公開資訊觀測站公告資訊為依據。



01

## 公司概況

公司沿革/全球據點

02

## 產品應用

產品應用/市場趨勢

03

## 經營績效

營收狀況/ 產品占比

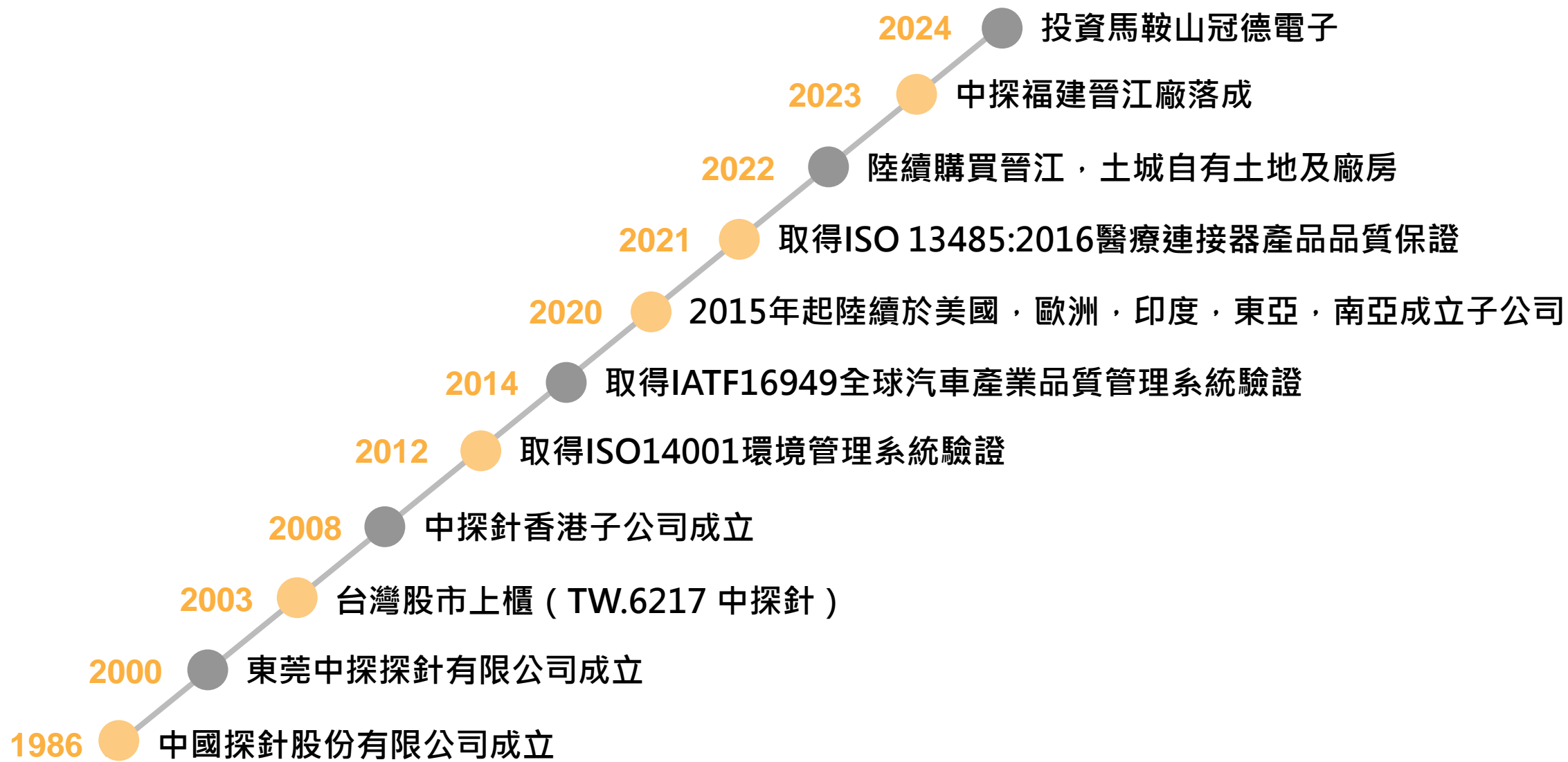
04

## 未來展望

產品趨勢/ 產品展望



# 公司概況

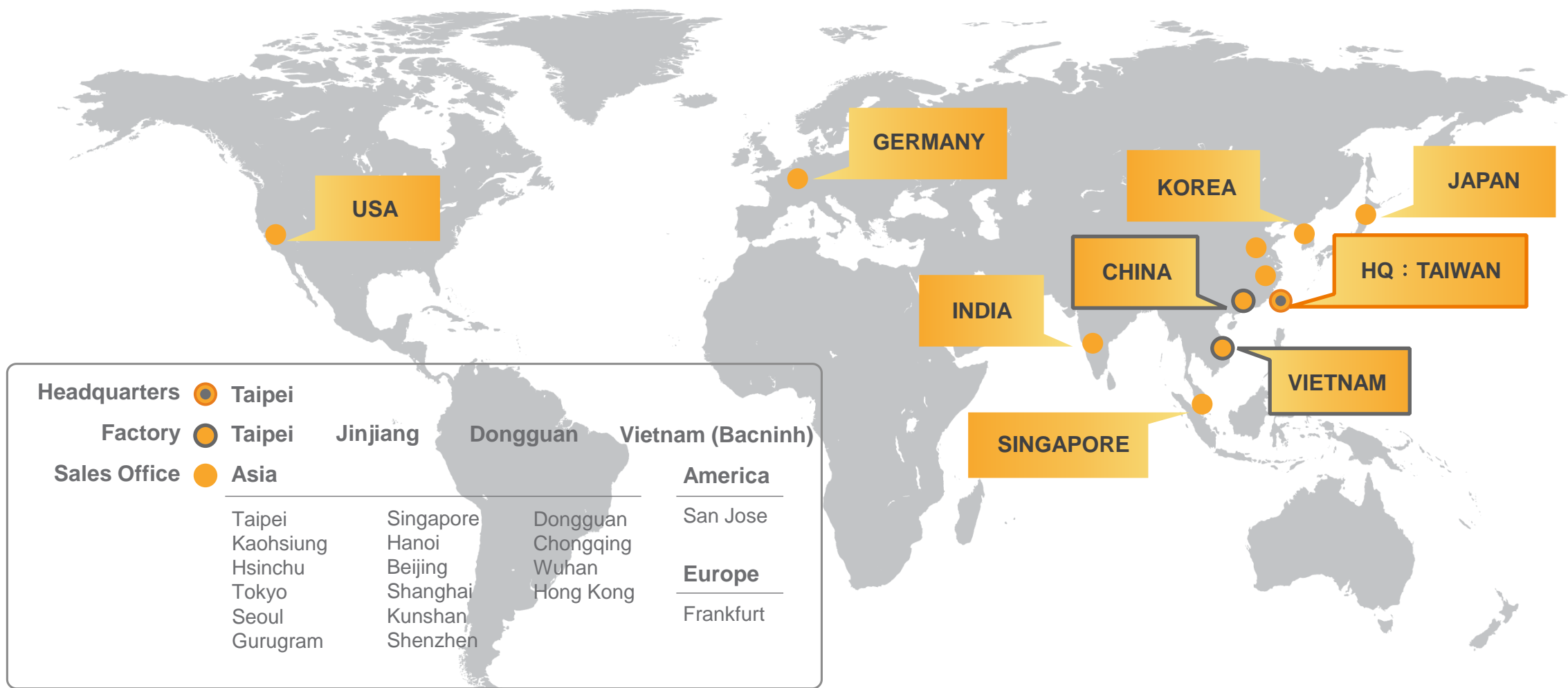




| 概覽  |  |             |
|---|--|-------------|
| 始建於2022年7月，2023年10月正式投產   |  |             |
| 產品類型  | 新能源產品，連接器，測試探針，大電流針，醫療產品，工業產品  |             |
| 生產能力  | 連接器：8000萬 pins/month;<br>測試探針：200萬 pins/month;<br>大電流產品：60萬 pins/month |             |
| 廠房面積  | 27000 m²   |             |
| 雇員  | 當前 650 人，計畫2025年擴充至800人規模  |             |
| 地址  | 福建省晉江市建興路393號  |             |
| 樓層信息  | #1 Building  | #2 Building |
| 1 <sup>st</sup> Floor   | IQC, 倉庫  | 注塑車間        |
| 2 <sup>nd</sup> Floor   | CNC車銑複合車間  | 精密加工車削中心    |
| 3 <sup>rd</sup> Floor   | 大電流應用產品線   | 連接器組裝車間     |
| 4 <sup>th</sup> Floor   | 測試類產品線   | 拉伸管&彈簧車間    |
| 5 <sup>th</sup> Floor   | Pogo產品線  | 預留產能擴充車間    |
| 品質管制體系資質  |  |             |
| IATF 16949:2016、ISO 045001、ISO 14001:2015、IECQ QC080000<br>ISO 13485、ISO14064、ISO 9001:2015 |  |             |



# 全球據點





# 產品應用





## High Current Connector

13A~250A

Electronic Vehicle  
High Current Conn.



## Medical Connector

Environmental Sensitivity

Circular Conn.  
Endoscope Conn.



Ready For  
**AI**  
Generation

## Pogo Pin Connector

1A~13A

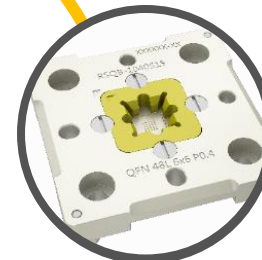
Pogo Pin Conn.  
Waterproof Conn.  
Magnetic Conn.



## Testing Solution

Fine Pitch

IC Testing Probe  
PCB Testing Probe  
Testing Socket



## Magnesium Alloy

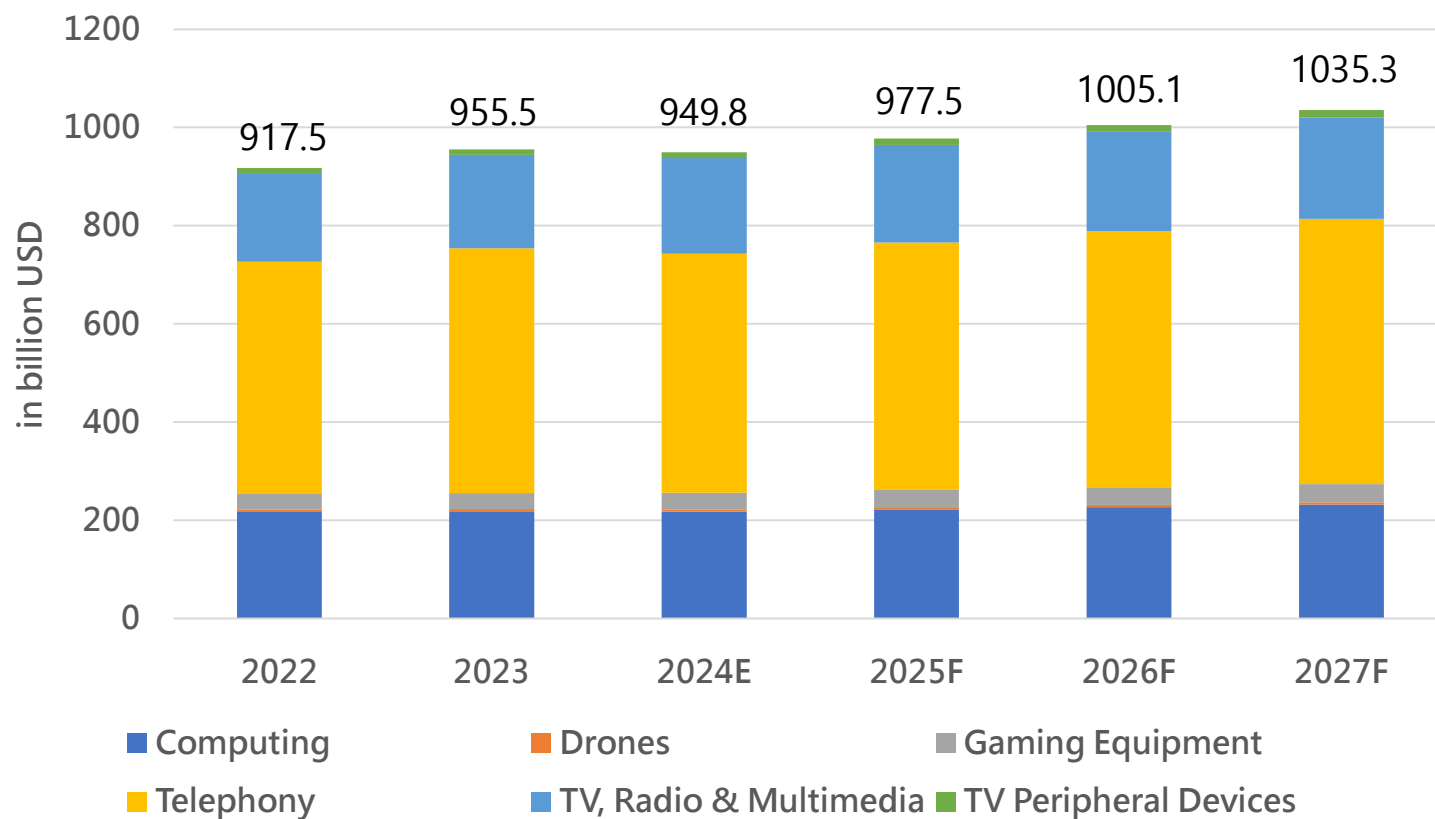
Lightweight, environmentally friendly & recyclable

NB PC/tablet, E-book appearance & structural parts  
Projector/Mobile phone/VR Frame  
Medical products/vehicle applications





# 產業趨勢- 全球消費電子市場持續增長



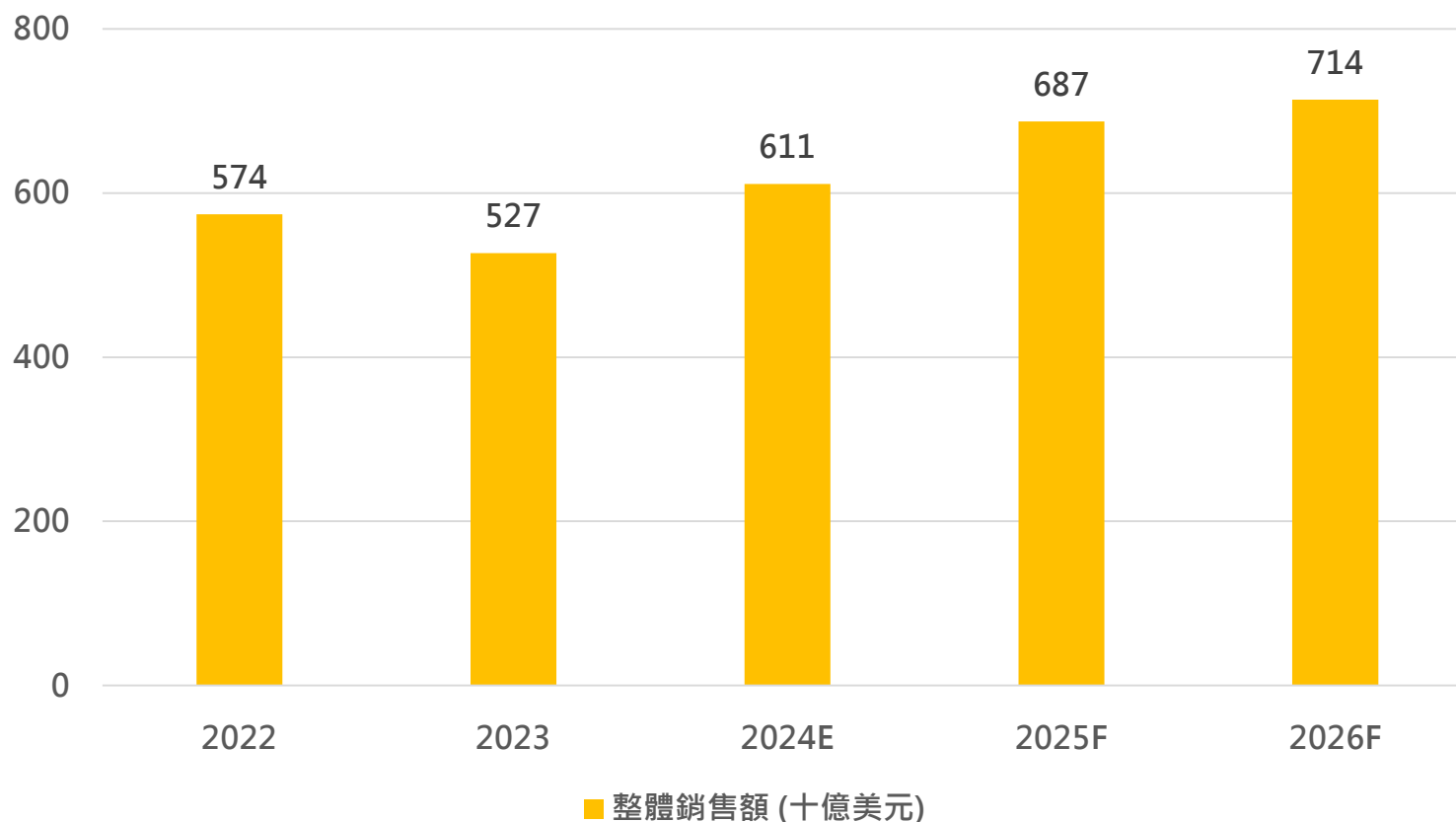
## 2024-2027 CAGR

# +2.9%

- ✓ 根據市調機構Statista報告指出，2024年全球消費市場規模將達約9500億美元。
- ✓ 消費性電子市場最大的細分市場是電話(包括智慧型手機、功能手機與固定電話等)，2024年市場規模將達到4,867億美元。
- ✓ 隨著生成式AI的熱潮，內建AI的智慧型手機與AI PC(含NB)將迎來另一波換機潮，還有AI穿戴式裝置、AI物聯網裝置等商機。



# 產業趨勢- 全球半導體市場需求



## 2024-2026 CAGR

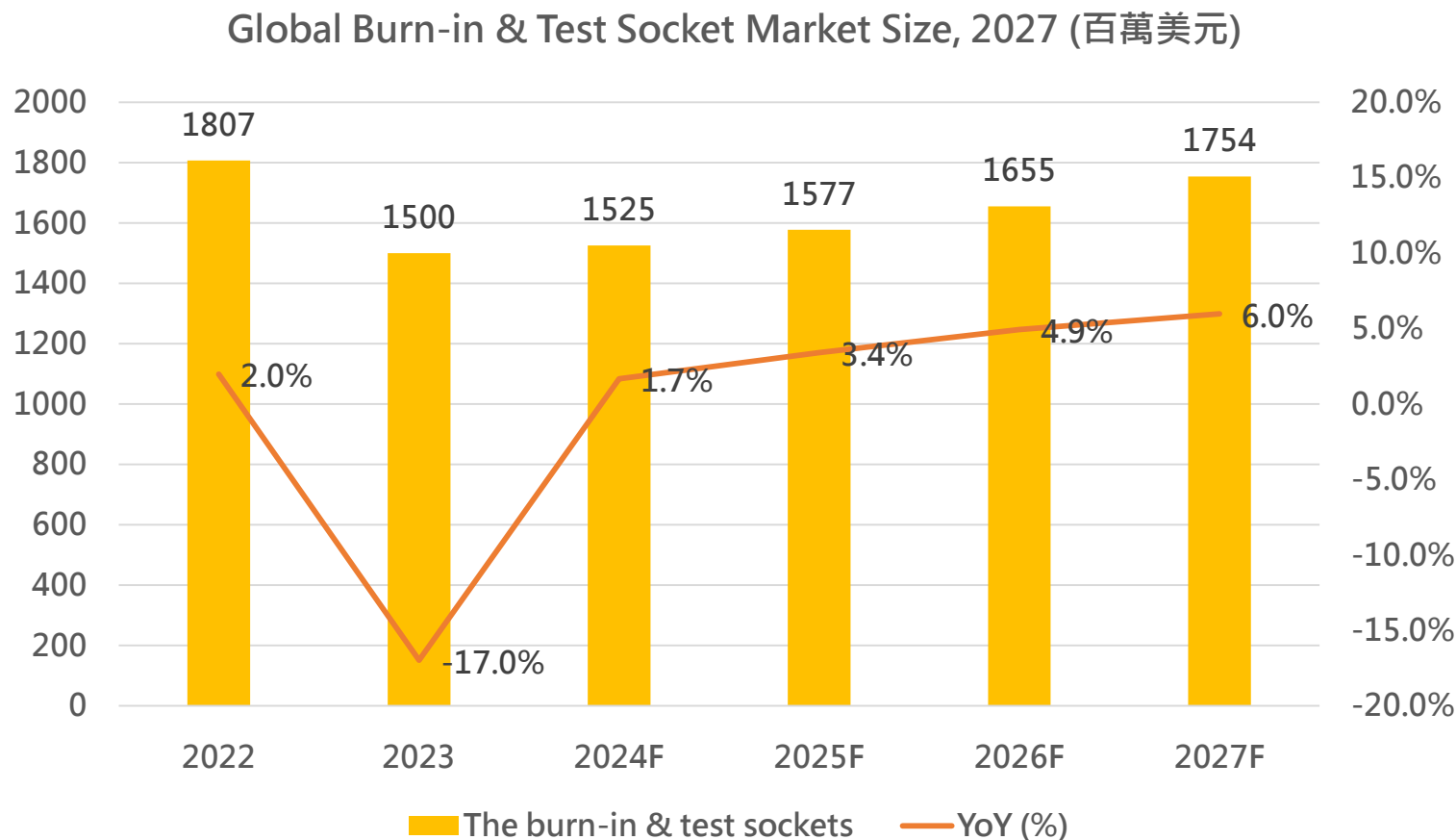
# +8.1%

整體半導體市場：

- ✓ 產品應用類型為半導體IC (記憶體IC、微元件IC、邏輯IC、類比IC) 及主要供應鏈潛在客戶為晶圓廠/design house/封測廠/實驗室。
- ✓ 隨著生成式AI的熱潮，內建 AI 的智慧型手機、AI PC (含NB)、AI穿戴式裝置、AI機器人與自駕車等對於先進半導體產品的需求將持續增長，對應產品需求提升Coaxial socket及High power Burn-in socket的需求。



# 產業趨勢- 全球半導體測試介面市場需求



## 2024-2027 CAGR

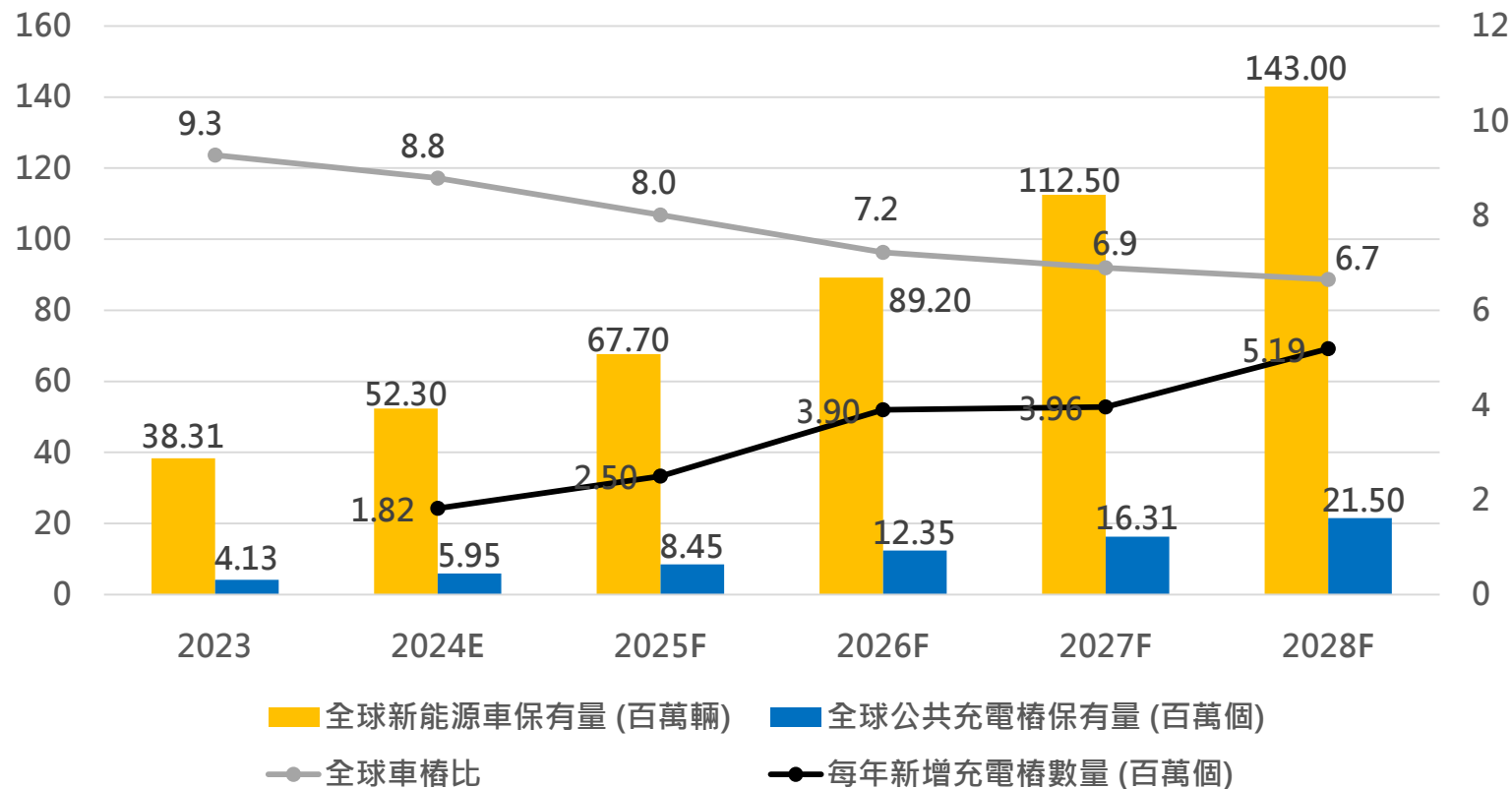
# +4.8%

- ✓ 根據國際市調機構Yole的預估，2023年全球半導體測試插座市值為15億美元，預計2027年將達17.5億美元，2024-2027年CAGR為4.8%。

# 產業趨勢- 全球新能源車與公共充電樁市場需求

2024-2027 CAGR

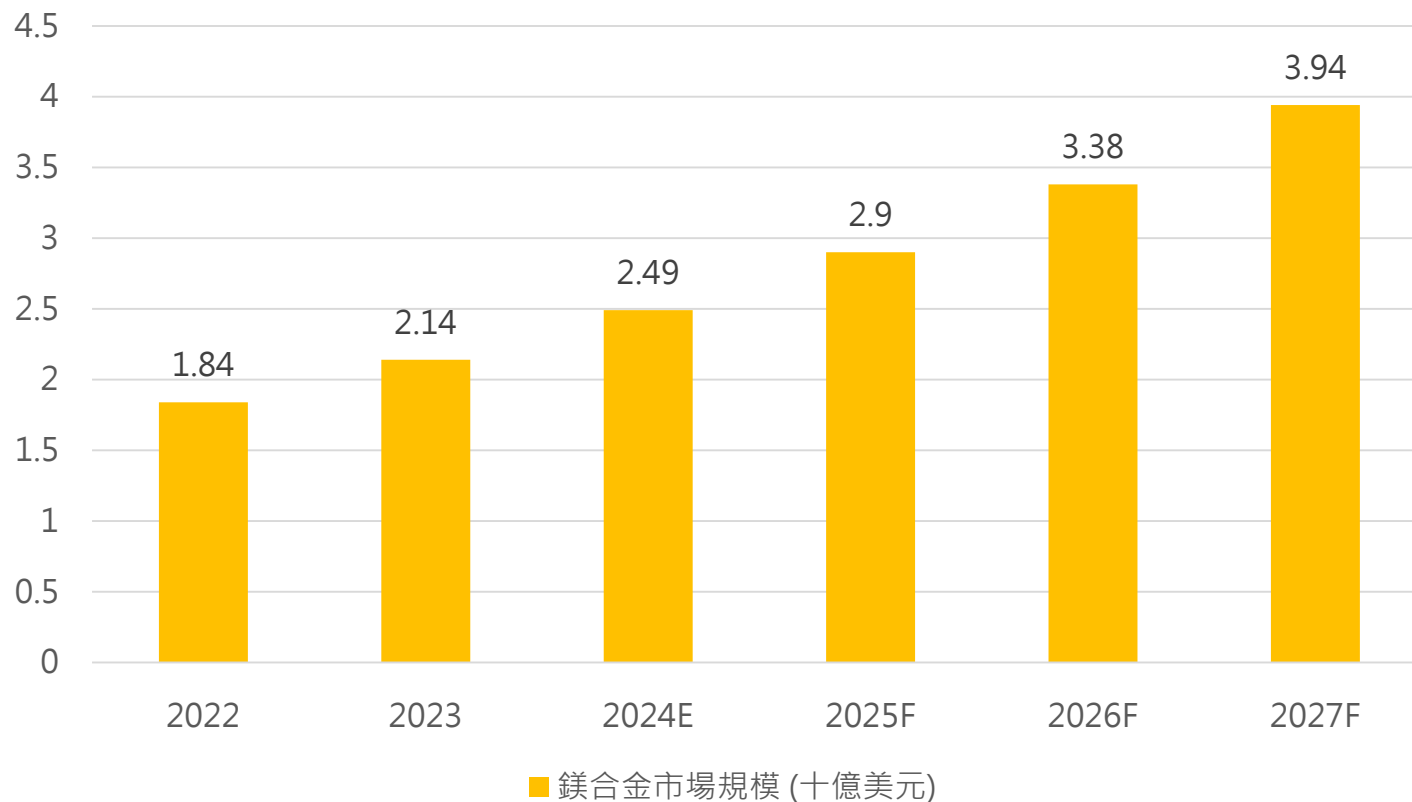
**+29.6%**



- ✓ 隨著全球各國政府的政策推動理想的車樁比 3 : 1 之下，全球公共充電樁對於充電槍的市場需求將十分可觀。
- ✓ 根據TrendForce的預估，全球2024年新增182萬個充電樁，至2027年將新增近4百萬個充電樁，2024-2027年CAGR為29.6%。



# 產業趨勢- 全球鎂合金市場需求



2024-2027 CAGR

**+16.5%**

- ✓ 2022年全球鎂合金市場規模為18.4億美元，從2023年的21.4億美元預估成長到2027年的39.4億美元。
- ✓ 鎂合金市場是輕量材料和冶金的重要領域，具有低密度和高強度重量比的特性。這些合金主要由鎂組成，包括鋁、鋅和錳等元素，對汽車、航太、消費電子和醫療設備等產業非常有吸引力。

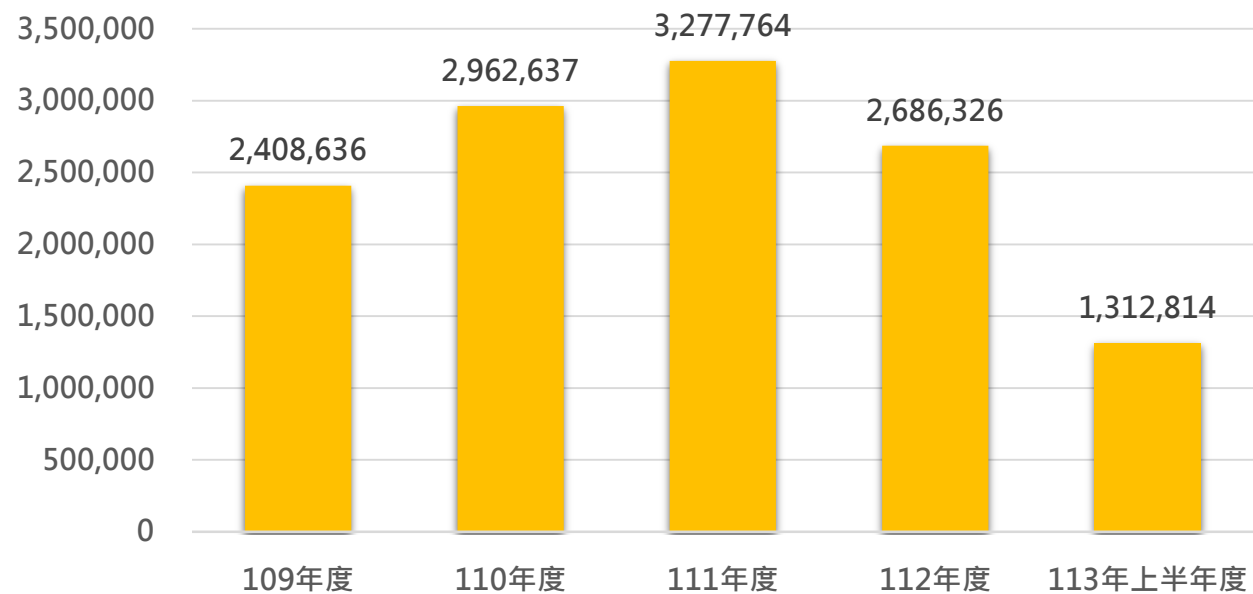


# 經營績效

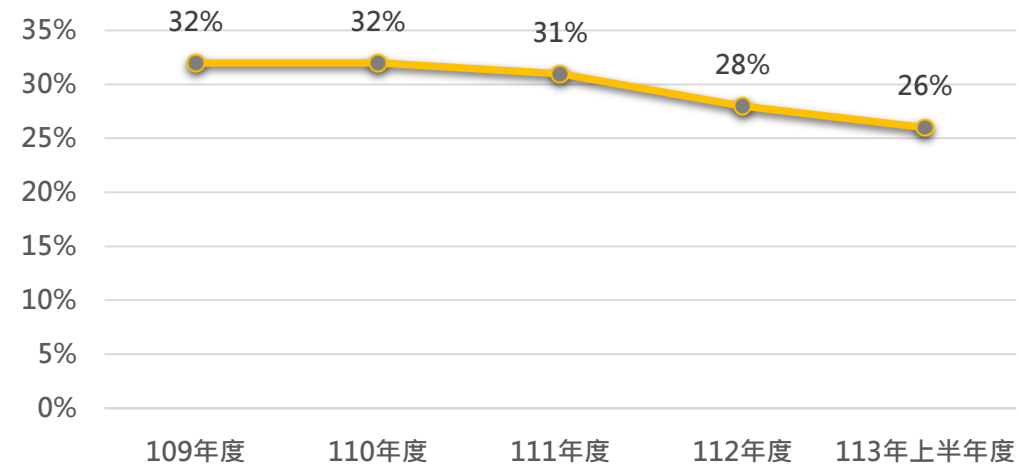


# 營收狀況

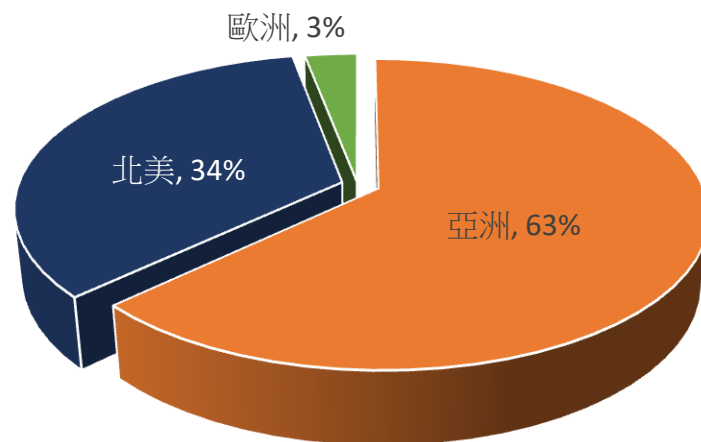
營業收入 (新台幣仟元)



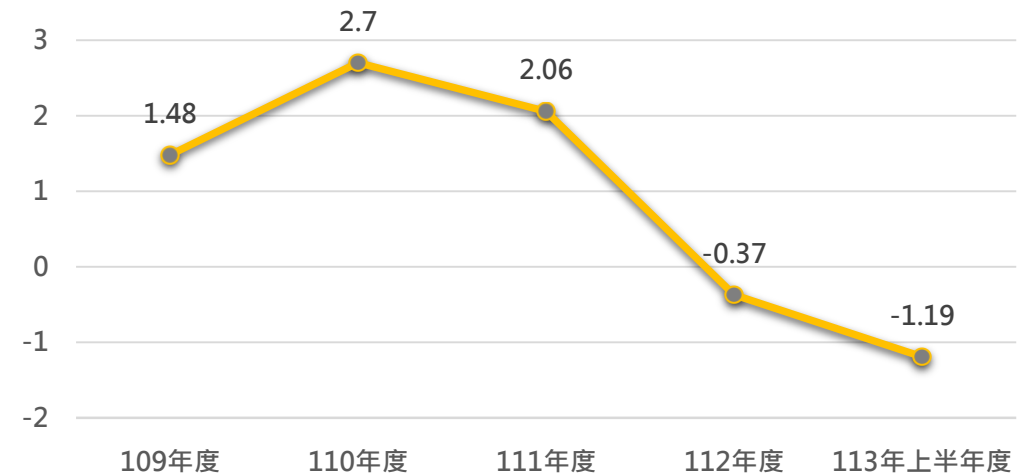
毛利率



營收依區域別占比



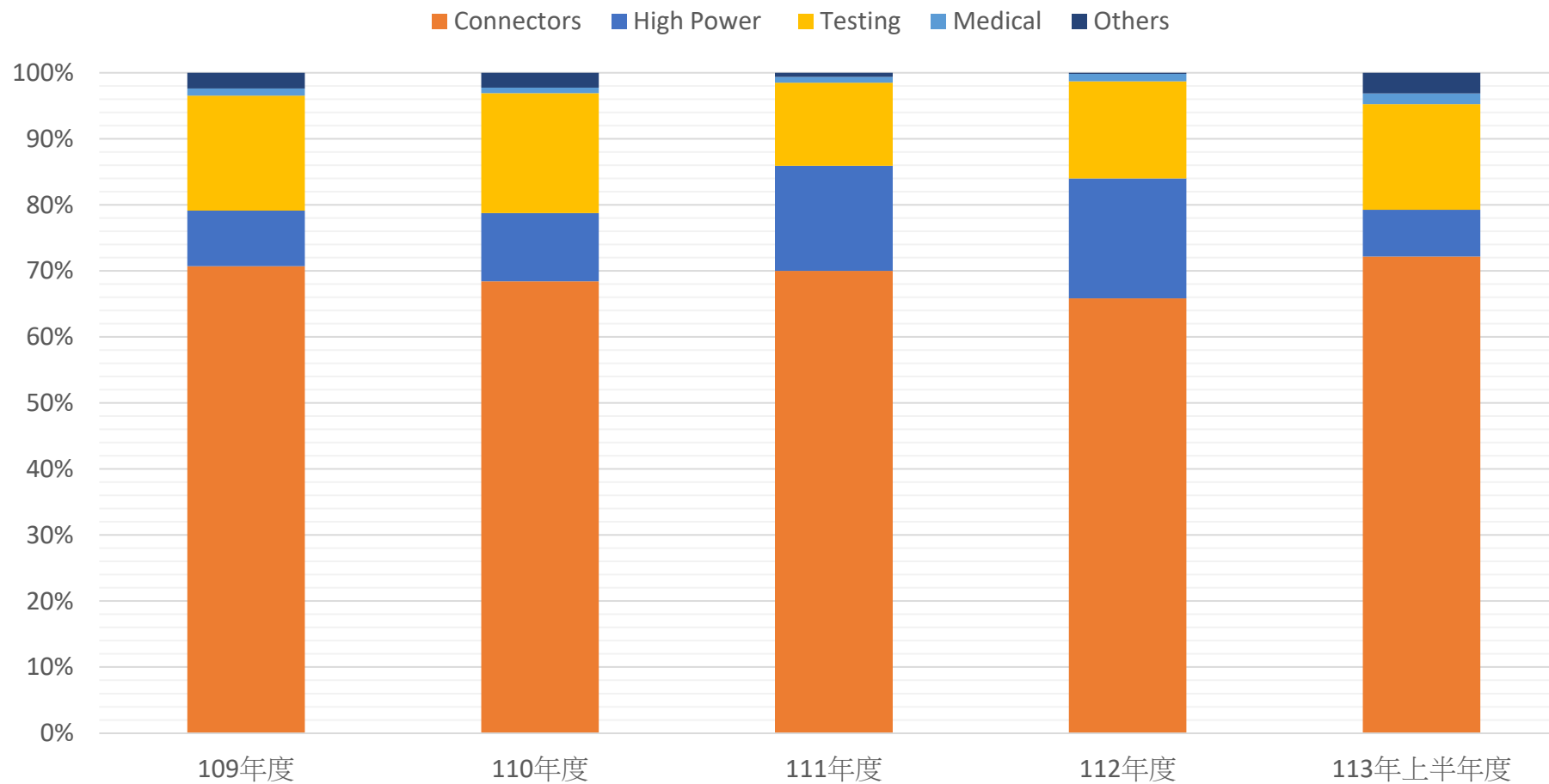
每股盈餘(元)







產品線收入占比 (近5年)





# 未來展望



# 未來展望 - 高功率老化測試(High Power Burn-in Socket)

2023

2024

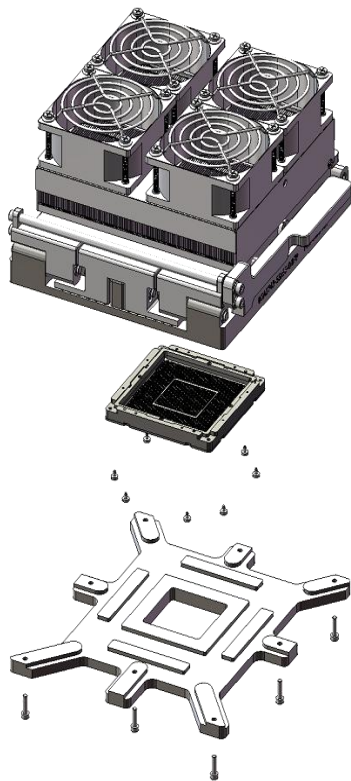
2025

AI人工智能晶片

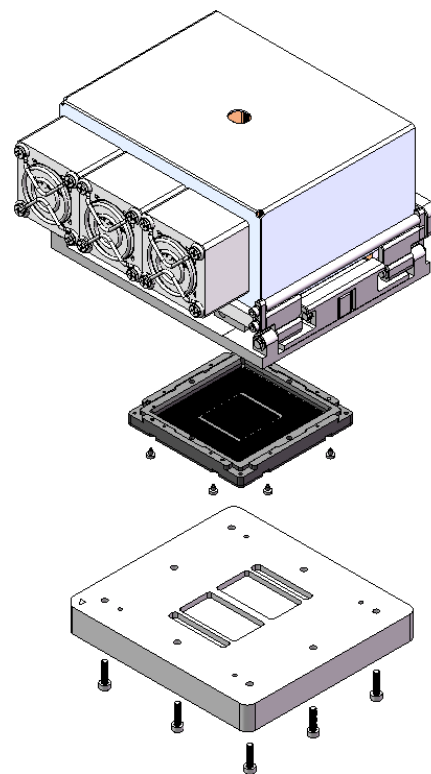
車用功率元件晶片

高速通訊晶片

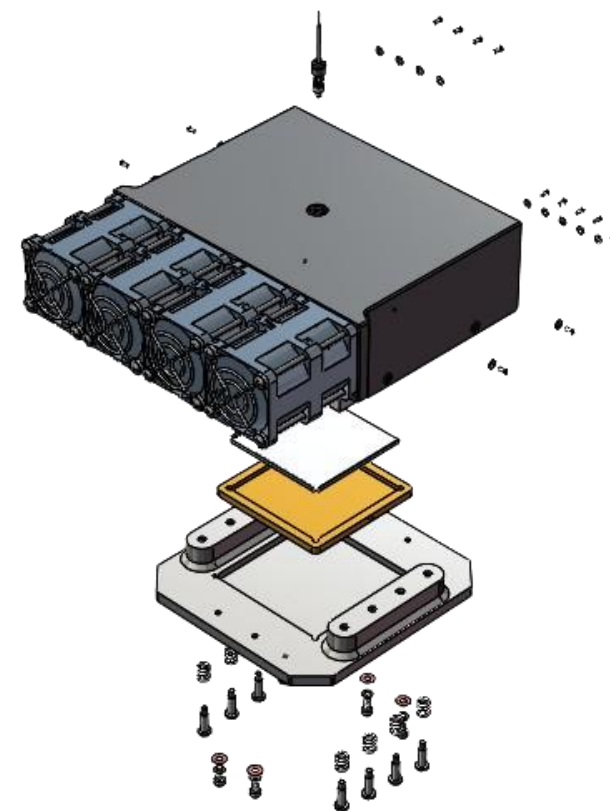
自動化設備晶片



500W



800W



1200W

微型化與精密化

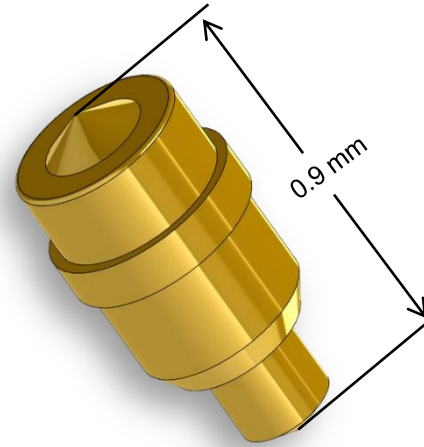
極端環境高可靠性

異材質進鍍層技術

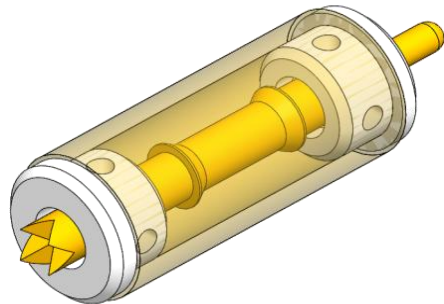
高速高頻線束模組

2024

Ultra Short Probe

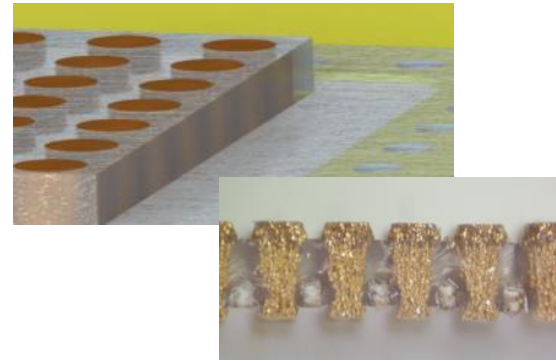


Coaxial Module

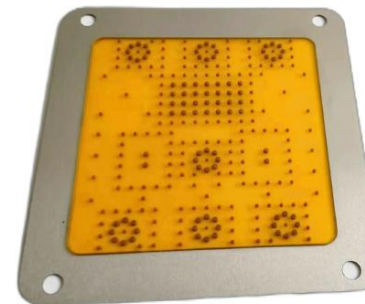


2025

PCR

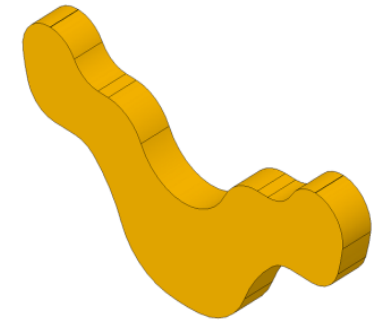


RF Module



2026

MEMS





# 224Gbps Hyper Socket

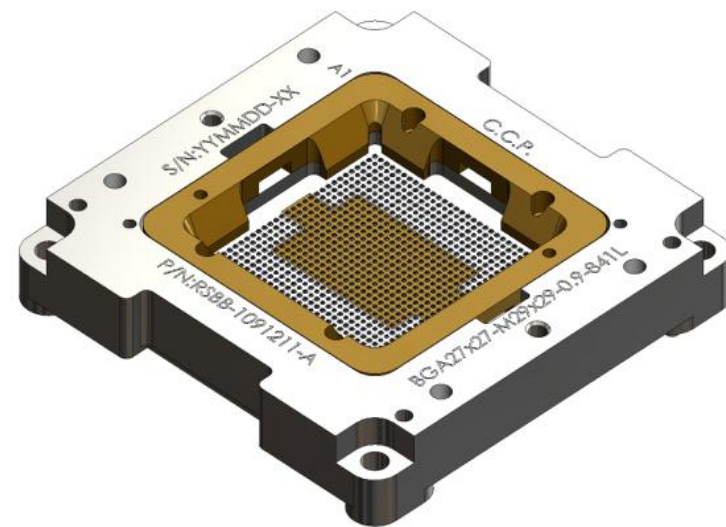
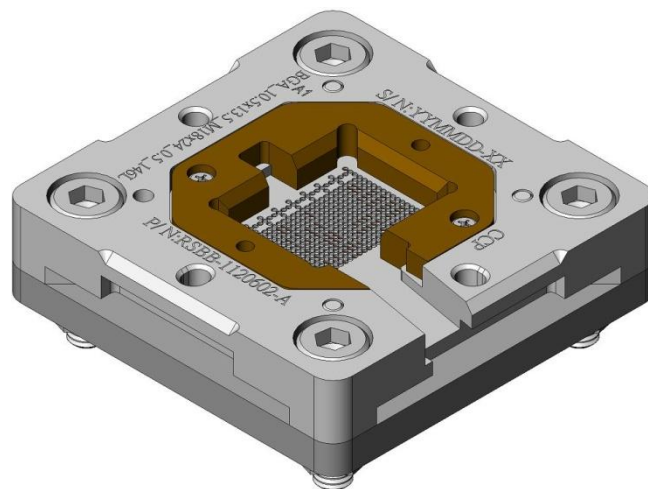
## 高頻同軸測試

數據中心與伺服器

雷達衛星通訊

智能手機無線設備

基地台與通訊設備

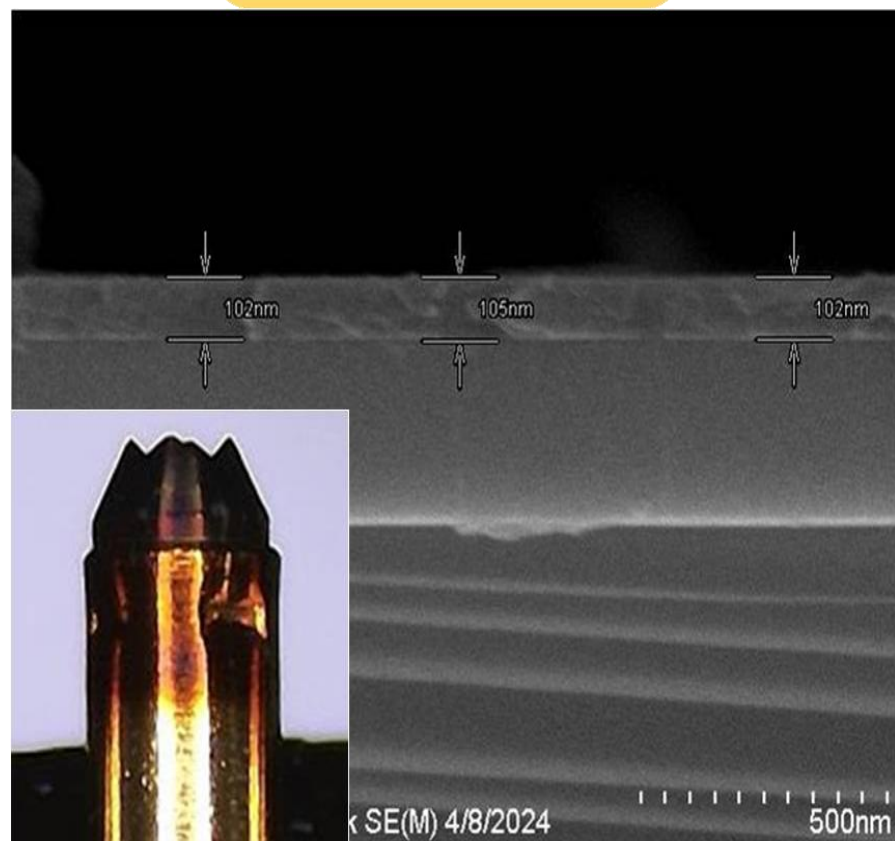


低沾黏

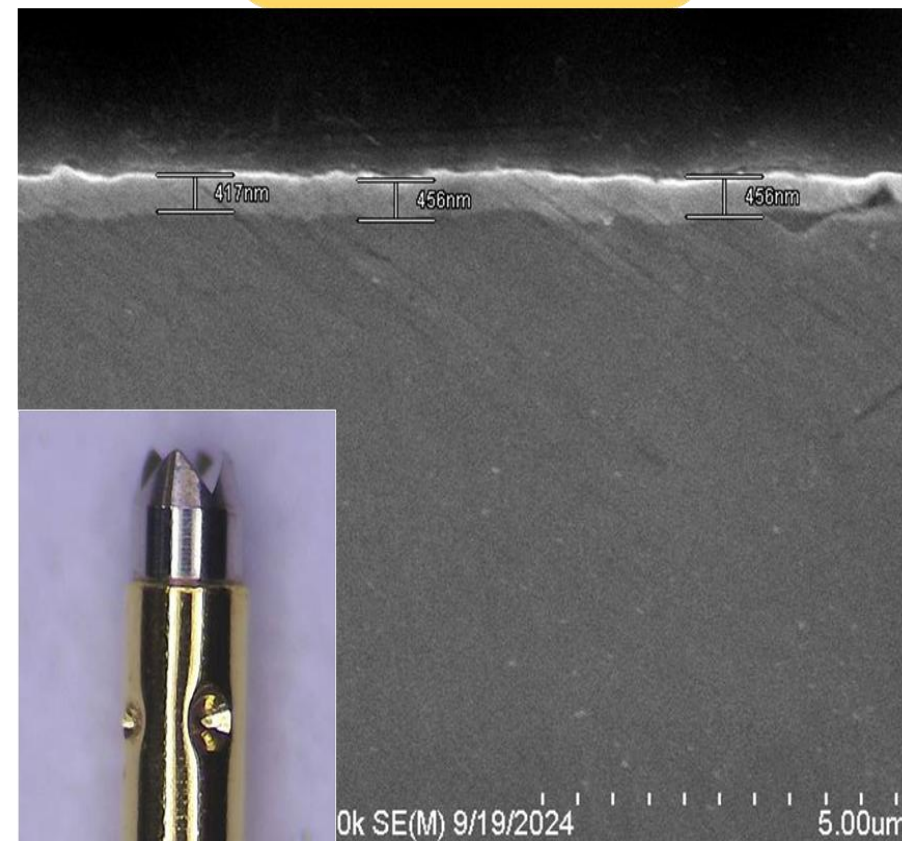
低接觸電阻

高測試使用壽命

DLC



GA





# 鎂合金材料應用

## 材料賦能

筆記型電腦外殼

車用電子設備

伺服器設備應用

航天航空應用







**CCP Contact Probes**

**Thanks for listening**

info@pccp.com.tw  
www.ccpccontactprobes.com

